



FX 500 Klinkier

Elastyczna zaprawa klejąca do okładzin klinkierowych

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca do klejenia płytek klinkierowych ręcznie formowanych o wysokiej nasiąkliwości. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Innowacyjna technologia **trasstec**.



WŁAŚCIWOŚCI

- elastyczna
- cienkowarstwowa
- wyprodukowana z wykorzystaniem technologii **trasstec**
- ogranicza ryzyko powstawania wykwitów i przebarwień
- EC 1 Plus - bardzo niski poziom emisji
- wydłużony czas otwarty
- zmniejszony spływy
- duża siła klejenia
- łatwa w obróbce
- wodoodporna i mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
- zalecana szczególnie do płytek klinkierowych formowanych ręcznie o wysokiej nasiąkliwości
- do klejenia płytek klinkierowych o niskiej nasiąkliwości na ścianach i posadzkach
- do klejenia płytek klinkierowych na balkonach i tarasach
- do stosowania na sztywnych i nieodkształcalnych podłożach takich jak cokoły budynków, kominy, słupki oraz podwaliny ogrodzeń
- do klejenia okładzin klinkierowych na systemach ociepleń quick-mix zalecane jest stosowanie Zaprawy klejącej **RKS**.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

- klasyfikacja kleju **C2 TE** wg **PN-EN 12004**
- spoiwo zgodne z normą **PN-EN 197**
- pod stałą kontrolą jakości zgodnie z **ISO 9001**
- zawartość chromu VI zredukowana do poziomu <2ppm

PODŁOŻE

Za pomocą kleju **FX 500 Klinkier** można kleić płytki klinkierowe na sztywnych i nieodkształcalnych podłożach mineralnych takich jak: beton, mury ceglane, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne. Podłoże musi być mocne, nośne, suche, czyste, nieprzemarznięte, wolne od kurzu, pyłu oraz resztek środków antyadhezyjnych. Luźne części podłoża oraz łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Podłoża chłonne zagruntować Emulsją gruntującą **UG**. W przypadku podłoży słabo nasiąkliwych, niechłonnych lub bardzo gładkich zaleca się zastosowanie warstwy szczepnej przy użyciu Mostka szczepnego **H4** lub Gruntu szczepnego **PHG**. Podłoże musi być wysezonowane - wiek podłoża powinien być większy niż 28 dni. Nierówności i ubytki w podłożu powinny zostać wyrównane za pomocą Szybkowiążącej zaprawy naprawczej **ZN 30**.

OBRÓBKA

Zawartość opakowania 25 kg wsypać do pojemnika z 5,0 do 5,5 l czystej wody i dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej **FX_500_KT**

wiertarki z mieszadłem, mieszać do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania zaprawę klejącą należy ponownie przemieszać a następnie zużyć w ciągu ok. 2-3 godzin.

W przypadku związania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne rozrabianie jej wodą. Przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z suchą zaprawą oraz z wodą w celu zmiany jej konsystencji.

Klejenie płytek klinkierowych o niskiej nasiąkliwości:

Za pomocą gładkiej pacy nanieść na podłoże najpierw tzw. warstwę kontaktową, następnie za pomocą pacy zębatej nanieść właściwą warstwę klejącą. Rozmiar zęba pacy należy dostosować do wymiaru płytek klinkierowych. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu „naskórkowania” tzn. przed upływem 30 minut. Płytki należy starannie docisnąć, następnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu. Płytki spoinować po ok. 3 dniach metodą szlamowania za pomocą Szybkowiążącej, elastycznej fugi **FF 911**.

Klejenie płytek klinkierowych o wysokiej nasiąkliwości na ścianach:

Płytki należy kleić tzw. metodą kombinowaną Battering-Floating. Na wcześniej przygotowane podłoże nanieść zaprawę za pomocą pacy zębatej. Na spodnią stronę płytek klinkierowych nanieść warstwę zaprawy klejącej o grubości ok. 1 mm. Następnie płytki mocno docisnąć do powierzchni zaprawy, delikatnie przesunąć i ustawić w ostatecznym położeniu. Zwrócić uwagę, aby pod okładziną nie pozostawały puste przestrzenie. Grubość zaprawy klejącej musi wynosić przynajmniej 3 mm. Fugi należy oczyścić na odpowiednią głębokość (przynajmniej na grubość płytek okładzinowych). Fugowanie można rozpocząć najwcześniej po upływie ok. 3 dni. W zależności od rodzaju okładziny płytki można fugować za pomocą Zaprawy do fugowania klinkieru **RSS** (metodą szlamowania). W przypadku zastosowania płytek klinkierowych lub innych okładzin, których grubość po przyklejeniu będzie wynosiła więcej niż 15mm do fugowania zalecane jest stosowanie zaprawy quick-mix **FM T**. Świeżą warstwę klejącą należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem jak również przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych (mróz, wiatr, deszcz itd.). Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C.

ZUŻYCIE

Paca zębata	Zużycie
4x4x4 mm	ok. 1,4 kg/m ²
6x6x6 mm	ok. 2,1 kg/m ²
8x8x8 mm	ok. 2,8 kg/m ²
10x10x10 mm	ok. 3,5 kg/m ²

Zużycie zaprawy klejącej może być różne w zależności od rodzaju podłoża i rodzaju płytek.

PRZECHOWYWANIE

W miejscu suchym na palecie drewnianej. Czas magazynowania 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

FORMA DOSTAWY

Worek 25 kg.

PERFEKCYJNY SYSTEM

- Wyrównanie podłoża: Jastrych cementowy **ZE 04**,
Szybkowiążąca zaprawa naprawcza **ZN 30**, Cementowa masa szpachlowa **BRS**
- Gruntowanie podłoża: Emulsja gruntująca **UG**
- Izolacja podłoża: Elastyczna powłoka uszczelniająca **FDF**,
Elastyczna zaprawa uszczelniająca **FDS 1K** oraz **FDS 2K**
- Fugowanie: **FF 911**, **RSS**, **RFS**, **FM T** w zależności od rodzaju płytki

UWAGA

Produkt ten zawiera cement, który może powodować uczulenie. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą, należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Przedstawione informacje techniczne uzyskano w wyniku licznych prób i wieloletnich doświadczeń praktycznych. Nie dają się one jednak przenieść na każdy wariant zastosowania. Dlatego też zalecamy wykonanie we własnym zakresie prób zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian zleceń technicznych w ramach rozwoju produktu.

DANE TECHNICZNE

klasa zaprawy:	C2 TE wg PN-EN 12004
czas dojrzewania:	ok. 5 min
czas zużycia:	ok. 2-3 godzin
czas otwarty	do 30 min.
temperatura obróbki:	+5°C do +25°C
zużycie wody:	od 5,0 do 5,5 l na 25 kg
splyw wg normy PN-EN 12004:	≤ 0,5 mm
zużycie:	ok. 1,4 kg /m ² /1mm grubości
magazynowanie:	w suchym miejscu 12 miesięcy od daty produkcji
opakowanie:	25 kg

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23°C i 50 % wilgotności względnej powietrza.



Patrz data produkcji wydrukowana na opakowaniu

quick-mix Sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Zakład Produkcyjny
Nr 60: ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin
Nr 61: ul. Opoczyńska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

PN-EN 12004:2008

Klej do płytek, cementowy o podwyższonych parametrach, o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym

Reakcja na ogień	Klasa A1/A1 _{fl}
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²

Stan: styczeń 2013

Z chwilą wydania nowej karty technicznej niniejsza wersja traci swą ważność

Szersze informacje można uzyskać:

quick-mix sp. z o.o.
ul. Brzegowa 73
57-100 Strzelin
tel. 71/ 392 72 20, 15
fax. 71/ 392 72 23, 24
e-mail: info@quick-mix.pl
www.quick-mix.pl